

捷運土城線頂埔站土地開發案

臺北市府捷運局

報告人：魏國華代理處長

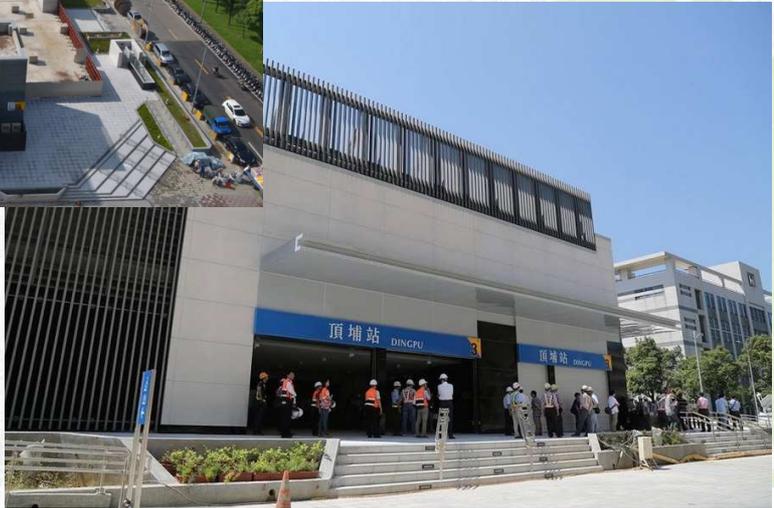


2015.11.26

基地區位



基地現況



捷運交會站、產創再發展



- 捷運5號板南線於頂埔站與三鶯線聯結，將雙北市重大科技園區串聯，如頂埔科技園區、土城工業園區、南港軟體工業園區等，使其創造產業的再發展及擴大就業機會。

土地使用分區

- **本基地容積獎勵**，適用「大眾捷運系統土地開發辦法」等，獎勵面積之總和不得超過法定容積之0.5倍。



項目	
都市計畫分區	產業專用區(四)
土地面積	5,177.27 m ² (1,566.12坪)
建蔽率/容積率/最高容積率	70% / 400% / 600%
最大容積總樓地板面積	31,063.62m ²

預計辦理期程



發展定位構想

頂埔站位頂埔科技園區中心，近土城工業園區。



開發構想示意圖



構想二



構想一

投資開發規範

■ 市府協助事項

1. 已施作完成開發大樓共構部分，包括頂埔站3號出入口地面層及土開共構之B1至B5地下層。
2. 已配合於臨中央路側，設置臨時停靠彎及計程車招呼站。
3. 104年5月13日辦理現場會勘，確認無法足額設置土地開發建築物應設置法定停車空間，實設數量未來依都市設計審議結果辦理。無法附建之法定停車位，若經地方交通主管機關審查認定同意免設時，依交通部90年5月9日交路90字第033014號函，免繳納代金。
4. 本開發案應回饋新北市政府之樓地板，其使用用途由捷運局協助確認。

投資開發規範

■ 投資者配合事項

1. 得標人應按本契約約定，臨中央路2F至4F預留部分空間供未來捷運三鶯線之使用，一併設計興建捷運三鶯線頂埔站出入口，其建造費用由政府支付。捷運設施需求空間及其設計，應依相關捷運規劃及設計手冊規定辦理，銜接界面應予協調整合。
2. 得標人於本基地興建之建物，包含應捐贈回饋新北市政府之樓地板面積約4,138.03 m² (約1,251.75坪)。(回饋樓地板面積 = 3,940.98 m² × 30% × 基地平均容積(暫估250%+150%+200%/2) × 0.7；該建造成本依甄選須知規定辦理)。
3. 得標人應依捷運土地開發投資甄選暨權益分配(改良式超額盈餘分配)標準作業程序辦理權益分配。
4. 得標人應依契約約定歸墊捷運局已墊支之相關費用。
5. 捷運獎勵容積樓地板面積之半數由土地開發基金支付建造成本取得，其應持分土地所有權無償取得；都市計畫獎勵樓地板面積之半數及其應持分土地所有權，依都市計畫規定辦理。

投資發展潛力

- 本案土地面積**5,177.27平方公尺 (約1,566.12坪)**，最高可建樓地板面積約**31,063.62平方公尺 (約9,396.75坪)**
- 緊鄰土城線頂埔站，區域內有多個科技產業，本案具由規劃住宅、商場與科技廠辦之開發潛力，可開發為**結合轉乘設施, 商場及住宅之生活與科技複合大樓**。
- 地主與投資人分收比：以投資人招商時承諾之比例為準。

